



# 中华人民共和国国家标准

GB 13555—92

---

## 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜

Flexible copper-clad polyimide film  
for printed circuits

1992-07-08 发布

1993-04-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜  
GB 13555—92

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.bzcb.com](http://www.bzcb.com)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 12 千字  
1992年12月第一版 2005年8月第二次印刷

\*

书号: 155066·1-23417 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜

GB 13555—92

### Flexible copper-clad polyimide film for printed circuits

本标准等效采用国际标准 IEC 249-2-13(1987)《印制电路用基材第二部分:规范,规范№13:一般用途的挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜》和 IEC 249-2-15(1987)《印制电路用基材第二部分:规范,规范№15:限定可燃性的挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜》。

#### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜的各项性能要求。

本标准适用于印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜。

本标准规定有“供选用”的技术要求,这些要求只有在供需双方同意的情况下才适用。在没有要求的情况下,满足所有未注明“供选用”字样的技术要求,则认为符合本标准。

#### 2 引用标准

GB 4721 印制电路用覆铜箔层压板通用规则

GB 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法

GB 5230 电解铜箔

GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

#### 3 产品分类

挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜有二个型号,其代号和特性如表 1。

表 1 挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜品种和型号

型 号	特 性
CPI-101	一般用途的
CPI-102F	限定可燃性的

注:CPI-101 型相当于 IEC 249-2-13 型;CPI-102F 型相当于 IEC 249-2-15 型。

#### 4 材料组成

本材料由挠性聚酰亚胺薄膜绝缘基材,一面或两面覆以铜箔构成,可用或不用粘合剂。

##### 4.1 绝缘基材

##### 4.1.1 聚酰亚胺薄膜

聚酰亚胺薄膜的推荐厚度和极限偏差如表 2 所示,在供需双方同意时,也可以采用其他厚度。